

二〇二六年集成电路企业 税收优惠政策申报（清单申请）说明



江苏省半导体行业协会
江苏省集成电路产业技术创新战略联盟
2026年4月

本次主要是针对申请国家发改委集成电路企业税收政策优惠清单的说明。此前对“专请核查”方式申报进行了专题说明，想了解这方面内容请查询上一个讲稿

国家发改委等部门《关于做好2026年享受税收优惠的集成电路企业或项目清单制定工作的通知》（发改高技【2026】487号）已经发布，申报截止时间是4月19日。这项工作很紧迫。为帮助大家做好申报工作，根据该通知结合以往工作经验，就集成电路税收优惠内容和途径、国家发改委优惠清单涵盖的内容和条件、材料准备、内容填报和注意事项进行说明，供申报过程中参考。

一、优惠政策内容和申报途径简介

二、各类企业优惠内容和条件

三、申报方法和材料准备

四、申报过程中注意事项

一、优惠政策内容和申报途径简介



一、优惠政策内容和申报途径简介

集成电路企业可以申请享受的税收优惠政策：

- ◆ 企业所得税减免
- ◆ 提高研发费加计扣除比例（研发费按照实际发生额的120%在税前扣除，以下简称：**研发费120%**）
- ◆ 免征进口关税
- ◆ 增值税加计抵减（进项税额加计15%）
- ◆ 进口环节增值税分期缴纳

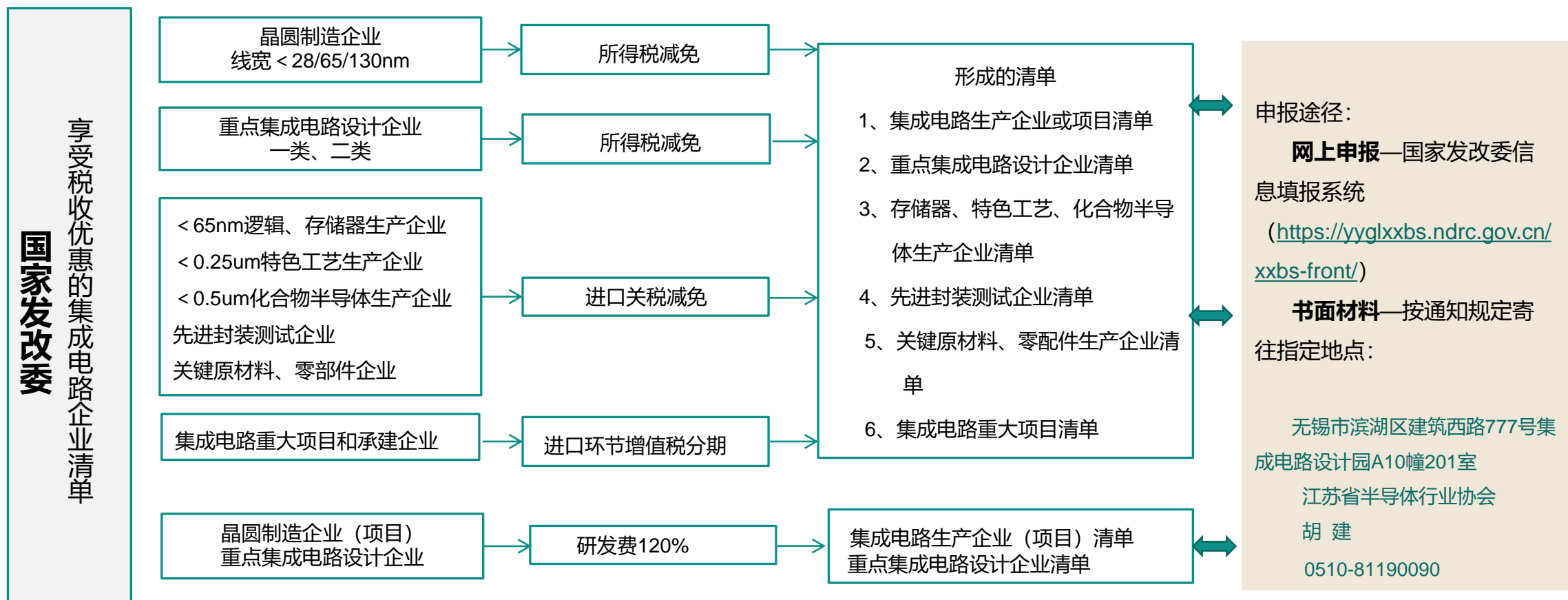
申报的途径：

- ◆ **清单申请【一】**（国家发改委优惠清单，4月份线上申报，也就是当前正在进行的）
集成电路生产企业、重点设计企业所得税减免和研发费120%；
逻辑电路、特色工艺、化合物半导体生产企业，先进封装企业，特定品种的关键材料、零配件企业免征进口关税；
集成电路重大建设项目进口环节增值税分期缴纳。
- ◆ **清单申请【二】**（国家工业和信息化部优惠清单，9月下旬或10月上旬，线上申报）
集成电路企业增值税加计抵减（进项税额加计15%）。
- ◆ **转请核查**（线下申报，向税务窗口递交书面材料；所得税3月中旬、6月中旬，研发费120% 3月底左右）
集成电路设计、封装测试、材料、装备（零部件）企业所得税减免；
集成电路封装测试、材料、装备（零部件）企业研发费120%。

注：增值税加计抵减
不在本次申报范围！

一、优惠政策内容和申报途径简介

国家发改委 享受税收优惠的集成电路企业（项目）清单内容（自2021年开始）



一、优惠政策内容和申报途径简介

几点说明：

- ◆ 今年申报条件和要求与去年相同，申报系统 (<https://yyglxxbs.ndrc.gov.cn/xxbs-front/>) 开放时间：4月7日—4月19日24点。

相关规定参考去年文件：

《关于做好2026年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》发改高技〔2026〕487号

附件1：享受税收优惠政策的企业条件和项目标准

附件2：重点集成电路设计领域和重点软件领域

附件3：享受税收优惠政策的集成电路企业、项目和软件企业提交材料明细表

附件4：企业重大变化情况表

- ◆ 集成电路企业税收优惠是普惠政策，各类所有制企业都可以申请享受；但不是自动享受，需满足规定条件并经过申报和批准；而且每年都要申报（不同于高新技术企业等资格认定）。

- ◆ 不在本次清单申报范围的企业或项目：

— 集成电路设计企业（一般）、集成电路封装测试、材料、装备（关键零部件）企业所得税减免；

— 集成电路封装测试、材料、装备（关键零部件）企业研发费120%；

— 不在规定类别范围的集成电路材料、关键零部件减免关税；

— 集成电路企业增值税加计抵减。

- ◆ 优惠政策仅面向集成电路企业，不包括延伸的泛半导体（光伏、新型显示、LED、PCB等）企业和整机企业。

**注：增值税加计抵减
不在本次申报范围！**

二、各类企业优惠内容和条件



插页

江苏省半导体协会每年度编印《集成电路产业发展研究报告》(近400页),已经连续坚持发行了十多年,成为企业、政府、研究咨询机构的重要参考资料,获得业界广泛认可。

2025年度《集成电路产业发展研究报告》,自去年9月启动筹备,经全体工作人员9个多月的精心编撰与打磨,将于今年6月正式发行。该报告由协会自筹经费、自主组织编写和发行。为了进一步丰富内容、展示企业形象与产品优势,正式印刷的“报告”中特设了彩色宣传插页,欢迎各单位刊登宣传内容。希望得到大家支持!

有需求的单位,请联系协会会员服务部部长陈浩鹏(电话&微信:13485177790)。

感谢各位的关心与支持!



二、各类企业优惠内容和条件—集成电路生产企业（项目）所得税减免和研发费120%

1、集成电路生产（晶圆制造）企业（项目）所得税减免内容

对象	内容
线宽≤28纳米	十年免税
线宽≤65纳米	五免五减半
线宽≤130纳米	两免三减半

- 可以按照集成电路项目享受对应范围的所得税优惠，需要能对项目单独进行会计核算、计算所得

2、集成电路生产（晶圆制造）企业享受所得税减免条件

条件	指标
本科以上学历职工人数占职工总数	≥30%
研发人员数占职工总数	≥20% (8吋线≥15%)
研究开发费总额占销售收入总额	≥2%
集成电路制造销售收入占企业收入总额	≥60%

- 符合国家布局规划和产业政策
- 拥有核心关键技术和自主知识产权
- 具有保证相关工艺线宽产品生产的能力和手段
- 无重大安全、重大质量事故和环境违法行为

3、集成电路生产（晶圆制造）企业研发费120%

- ◆ 范围和条件与所得税减免相同
- ◆ 可以两项都申报，也可以只选择其中的一项申报

二、各类企业优惠内容和条件——国家鼓励的重点集成电路设计企业所得税减免和研发费120%

- 1、国家鼓励的重点集成电路设计企业所得税减免**内容**：所得税五年免征，接续年度按照10%征收
- 2、国家鼓励的重点集成电路设计企业享受所得税减免**条件**（分为：一类、二类）

共性基本条件：

条件	指标
本科以上学历职工人数占职工总数	≥50%
研发人员数占职工总数	≥40%
研究开发费总额占销售收入总额	≥7%
集成电路设计销售收入占企业收入总额	≥70%
集成电路自主设计销售收入占企业收入总额	≥60%
拥有发明专利、布图、软著合计	≥8个

注1：重点设计企业是在满足设计企业基本条件（工信部2021年9号公告）基础上提高了要求，9号公告规定月平均职工人数不少于20人。

注2：设计销售收入：销售芯片、EDA工具、IP和设计服务的收入
自主设计销售收入：芯片销售收入中扣除代销芯片的收入

一类重点设计企业

汇算清缴年度，集成电路**设计销售收入**不低于5亿元，应纳税所得额不低于3000万元（收入50亿元以上不考核应纳税所得额，但研发费占比≥8%）

二类重点设计企业

- (1) 产品符合国家鼓励的重点集成电路设计领域（选择其一）；
- (2) 汇算清缴年度，集成电路设计销售收入不低于3000万元；
- (3) 应纳税所得额不低于350万元；
- (4) 选择领域的设计销售收入占本企业设计销售收入的比例不低于50%。

二、各类企业优惠内容和条件—国家鼓励的重点集成电路设计企业所得税减免和研发费120%

重点集成电路设计领域

- (一) 高性能处理器和 FPGA 芯片;
- (二) 存储芯片;
- (三) 智能传感器;
- (四) 工业、通信、汽车和安全芯片;
- (五) EDA、IP 和设计服务。

- ◆ 如业务范围涉及多个领域，仅选择其中一个领域进行申请。
- ◆ 选择领域的销售收入占本企业**集成电路设计销售收入**的比例不低于 50%。

3、重点集成电路设计企业研发费120%

- 研发费120%优惠的条件与所得税优惠条件相同;
- 可以两项都申请，也可以仅申请其中的一项;
- 如果同时申请了提高研发费加计扣除比例，**应纳税所得额要按照研发费加计120%计算。**

二、各类企业优惠内容和条件——生产企业、先进封装企业、关键原材料零配件企业免征进口关税

可申请的**对象**：

- 线宽小于65纳米（含）的逻辑电路、存储器生产企业
- 线宽小于0.25微米（含）的特色工艺集成电路生产企业
- 线宽小于0.5微米（含）的化合物集成电路生产企业
- 先进封装测试企业
- 关键原材料、零配件（仅限8类：靶材、光刻胶、掩模版、封装基板、抛光垫、抛光液、8英寸及以上硅单晶、8英寸及以上硅片）生产企业

优惠内容——**免征进口关税**

大概的范围：

- 国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性（含研发用,下同）原材料、消耗品；
- 净化室专用建筑材料、配套系统；
- 集成电路生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件；
- 集成电路生产企业、重点设计企业、先进封装测试企业进口自用设备，及按合同随设备进口的技术（含软件）及配套件、备件。

二、各类企业优惠内容和条件—生产企业、先进封装企业、关键原材料零配件企业免征进口关税

申请条件:

首先满足“符合国家布局规划和产业政策，上年度未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为”。

◆ 逻辑电路、特色工艺、化合物半导体生产企业

——具有保证产品生产的手段和能力。

◆ 先进封装测试企业

——上年度企业先进封装测试（晶圆级封装、系统级封装、2.5维和3维封装）**规划产能占总规划产能比例**，按封装产品颗粒数或晶圆数（折合8英寸）计算不低于40%；

——具有保证产品生产的手段和能力。

◆ 关键原材料、零配件企业

——具有保证产品生产的手段和能力；

——产品在规定的范围内。

二、各类企业优惠内容和条件—进口环节增值税分期纳税

进口环节增值税分期纳税**优惠内容**：首台设备进口之后的6年（连续72个月）内**进口环节增值税**分期缴纳
（首年免缴，后五年各缴20%）

享受对象：芯片制造类、先进封装测试类重大项目承建单位

申请条件：

- 符合国家布局规划和产业政策
- 线宽 < 65 纳米逻辑电路、存储器项目，投资额超过80亿，月产能超过1万片（12吋）；
- 线宽 < 0.25微米 模拟、数模混合、高压、射频、功率、光电集成、MEMS、SOI，投资 > 10亿，月产能 > 1万片（8吋）；
- 线宽 < 0.5微米 化合物半导体，投资规模 > 10亿，月产能 > 1万片（6吋）
- 先进封装测试，投资规模 > 10亿，年产能 > 10亿颗芯片或50万片晶圆（折合8吋）

三、申报方法和材料准备



三、申报方法和材料准备（步骤1：阅读理解当年的申报通知）

1

下载并认真研读当年的申报通知和附件

国家发展改革委等部门的申报通知（发改高技〔2026〕487号、国家发改委官网）包括：

《关于做好2026年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》

附件1：享受税收优惠政策的企业条件和项目标准

附件2：重点集成电路设计领域和重点软件领域

附件3：享受税收优惠政策的集成电路企业、项目和软件企业提交材料明细表

附件4：企业重大变化情况表

注：在2023年“申报通知”中，有附件5：“申报系统操作手册”可以参考（包括申报系统技术支持的联系方式）

江苏省发展改革委、工业和信息化厅通知（苏发改高技发[202×]×××号）包括：

转发国家通知，明确书面材料的份数和要求，寄送地点和时间等

三、申报方法和材料准备 (注册线上申报系统)

2

优惠清单申报系统



The screenshot shows the login interface of the National Development and Reform Commission's online registration platform. At the top, there is the logo of the National Development and Reform Commission and its name in Chinese and English. Below this, the text '国家发展和改革委员会互联网统一认证平台' (National Development and Reform Commission Internet Unified Authentication Platform) is displayed. The login form includes a user name field (with a note that it is the unified social credit code), a password field, and a '登录' (Login) button. At the bottom of the form, there are links for '注册账号' (Register account), '忘记用户名?' (Forgot username?), '忘记密码?' (Forgot password?), and '常见问题' (Common questions).

网址: <https://yyglxxbs.ndrc.gov.cn/xxbs-front/>

系统开放时间: 4月7日—4月17日

今年增加: 申请**进口环节增值税**分期纳税政策的重大项目。还可以在**9月7日—9月20日**期间申报。

系统使用问题请找“2023年申报通知”附件
《申报系统企业填报使用手册》

系统支持: 18810748372 杨老师

申报系统对浏览器有一定要求, 有时需要
换个浏览器试试。

三、申报方法和材料准备 (选择申报项目入口)

3

选择申报项目入口

享受税收优惠的企业清单申报系统 [返回上一级](#)

- 《若干政策》第（一）条的集成电路生产项目申请（填报时间为2024年3月25日至4月16日）
- 《若干政策》第（六）条提及的先进封装测试企业申请（填报时间为2024年3月25日至4月16日）
- 《若干政策》第（六）条提及的集成电路生产企业和财税【2021】4号文提及的关键原材料、零配件生产企业申请（填报时间为2024年...）
- 《若干政策》第（三）、（七）条提及的国家鼓励的重点软件企业申请（填报时间为2024年3月25日至4月16日）
- 《若干政策》第（八）条的集成电路重大项目申请（填报时间为2024年3月25日至4月16日）
- 《若干政策》第（三）（七）条国家鼓励的重点集成电路设计企业申请（填报时间为2024年3月25日至4月16日）
- 《若干政策》第（一）条的集成电路生产企业申请（填报时间为2024年3月25日至4月16日）
- 《公告》提及的国家鼓励的集成电路设计企业申请（填报时间为2024年3月25日至4月16日）
- 《公告》提及的国家鼓励的集成电路生产项目归属企业申请（填报时间为2024年3月25日至4月16日）
- 《公告》提及的国家鼓励的集成电路生产企业申请（填报时间为2024年3月25日至4月16日）

- ★ 根据企业类型、优惠内容、条件符合情况，选择恰当的申报项目；
- ★ 可以选择多个项目，但不能相互冲突；
- ★ 谨慎选择、不要遗漏。

《若干政策》—国发〔2020〕8号《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》

《公告》—财政部税务总局国家发改委工信部公告2023年第44号《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》

三、申报方法和材料准备（认真阅读填报说明）

4

认真阅读填报说明

填报说明

填报时间为2026年4月7日至4月19日24时，烦请在此时间前提交。

《若干政策》第（一）条提及的国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含）、线宽小于65纳米（含）、线宽小于130纳米（含）的集成电路生产企业或项目（申报对象为集成电路生产企业和项目，对应企业所得税）

一、基本要求

- （一）申报系统仅可使用中文简体、英文字母、数字和符号填写；
- （二）上传附件类型为WORD、EXCEL、PDF、JPG、PNG等常见格式，压缩包支持zip格式；
- （三）所有标*项为必填项；
- （四）全部内容填写完成后如选择“暂存”，可以继续修改填报内容，如选择“提交”则无法修改填报内容，请谨慎选择。

二、企业基本信息

- （一）企业根据自身情况，选择按企业申报或按项目申报，并对应选择线宽类别。
- （二）若按项目申报，在企业名称等基本信息中，需填写主体企业相关资料。
- （三）企业信息务必与营业执照保持一致。
- （四）企业法人营业执照（副本）扫描件需在营业期限内，彩色或黑白复印后加盖企业公章进行扫描上传。
- （五）企业取得的其他相关资质证书，包括企业认为可以说明所从事业务以及技术水平的其他资质，不是必填项。

三、经营情况

- （一）月平均人数计算：月平均数=（月初数+月末数）÷2；年度月平均数=全年各月平均数之和÷12。
- （二）研发人员主要包括研究人员、技术人员和辅助人员。企业研究开发人员名单需excel格式交省级发展改革委（工业和信息化主管部门）备查。
- （三）线宽最小值和最大值是指企业已量产产品的线宽，企业已运转的设备能力应能满足对应线宽要求，对应提供有关纸质材料。
- （四）研究开发费用应按财税〔2015〕119号文及国家税务总局2017年第40号公告要求的口径归集后，在会计报告中单独说明，不能说明的需提供按照上述口径的研究开发费用专项审计报告或税务鉴证报告。
- （五）申报期内需上传经审计的会计报告，经审计的完整纸质版会计报告交省级发展改革委（工业和信息化主管部门）留档备查。
- （六）企业职工人数请准备汇算年度最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等备查，无需上传。

三、申报方法和材料准备（填报示例）

5

填报示例（1）

* 上传承诺书

点击上传

请下载承诺书模板，按要求签字盖章后，上传扫描件。最大支持上传1个文件，单个文件大小不超过10M，如文件过大，请压缩后上传。

* 所在地区

请选择省

注意：计划单列市及新疆建设兵团请拉到选项最后进行选择，请勿选择所在省。计划单列市包括：大连市、青岛市、宁波市、厦门市、深圳市。

申报类型

* 企业申报类型

线宽小于28纳米（含）生产企业 线宽小于65纳米（含）生产企业 线宽小于130纳米（含）生产企业

* 企业去年是否列入享受本条税收优惠政策的企业清单

是 否

请尽早下载《承诺书》
请企业负责人签字

三、申报方法和材料准备（填报示例）

5

填报示例（2）

企业基础信息

* 企业名称（中文全称）

0/50

* 注册资本（与营业执照内容保持一致，带单位）

0/50

* 企业负责人

0/50

* 企业负责人座机

0/50

* 联系人手机

* 联系人邮箱

* 初始获利年度

0/50

* 统一社会信用代码

0/50

* 注册地址

0/50

* 联系地址

0/50

* 企业负责人手机

* 联系人

0/50

* 联系人座机

0/50

* 企业成立日期

0/50
时间格式应为xxxx.xx.xx，例如2020.03.01

联系人手机必须准确，并保持畅通，申报周期内不要拒接电话。

三、申报方法和材料准备（填报示例）

5

填报示例（3）

经营情况

汇算清缴年度工艺及产能情况

* 线宽最小值 (nm)

* 线宽最大值 (nm)

* 规划月产能

8英寸及以下 8英寸及以下和12英寸 12英寸

汇算清缴年度企业人员构成情况

* 汇算清缴年度企业月平均职工总人数 (人)

* 汇算清缴年度企业月平均研发人员总人数 (人)

* 汇算清缴年度企业月平均本科及以上学历职工总人数 (人)

* 汇算清缴年度企业月平均本科及以上学历职工人数占企业月平均职工总人数的比例 (%)

★ 产能≠产量

★ 填报的数据要与佐证材料一致

三、申报方法和材料准备（填报示例）

5

填报示例（4）

汇算清缴年度知识产权情况

* 具有与主营产品相关的已授权发明专利数量（项）

 0/20

经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告

* 汇算清缴年度企业收入总额（万元）

备注（非必填）

 0/20 0/30

* 汇算清缴年度企业销售（营业）收入总额（万元）

备注（非必填）

 0/20 0/30

* 汇算清缴年度企业应纳税所得额（万元）

备注（非必填）

 0/20 0/30

* 汇算清缴年度集成电路制造销售（营业）收入（万元）

备注（非必填）

 0/20 0/30

* 汇算清缴年度集成电路制造销售（营业）收入占企业收入总额的比例（%）

此项为系统自动计算

* 汇算清缴年度研究开发费用总额（万元）

备注（非必填）

 0/20 0/30

★ 注明正确页码，减少审核期间的反复

三、申报方法和材料准备（填报示例）

5

填报示例（5）

此项为系统自动计算

* 上传会计报告

点击上传

包括会计报表、会计报表附注、财务情况说明书及所需的专项证明文件等。研究开发费用应按财税〔2015〕119号文及国家税务总局2017年第40号公告要求的口径归集后，在会计报告中单独说明，不能说明的需提供按照上述口径的研究开发费用专项审计报告或税务鉴证报告。上传最大支持上传5个文件，单个文件大小不超过20M，如文件过大，请压缩后上传。

其他相关证明材料附件上传

* 请知悉，以下材料请存档备查

- 与主营产品相关的发明专利证明材料
- 企业具有保证产品生产的手段和能力的证明材料（包括采购设备清单等）
- 企业主要工艺、产品列表
- 本项政策申报要求提交的其他证明材料

* 与主要客户签订的两份代表性销售合同扫描件（外文合同，请翻译成中文一并上传）

点击上传

合同首页+金额页+盖章页。上传最大支持上传9个文件，单个文件大小不超过10M，如文件过大，请压缩后上传。

省级发展改革委、工业和信息化主管部门要求出具的其他材料（非必填）

点击上传

上传最大支持上传9个文件，单个文件大小不超过10M，如文件过大，请压缩后上传。

* 上传企业申请表

★ 集成电路生产企业（项目）、逻辑电路特色工艺化合物半导体生产企业、先进封装测试企业、关键材料零部件企业请把“**备案证明**”上传到“企业取得的其他相关资质证书”栏目内。高新企业等证书、体系认证证书等也建议上传到这个栏目。

★ 《专利证书》等自主知识产权证明，请上传到“省级发改委、工业和信息化主管部门要求出具的其他材料”栏目下。

三、申报方法和材料准备 (填报示例)

5 填报示例 (6)

享受税收优惠的企... ^

- 《公告》提及的国家...
- 《公告》提及的国家...
- 《公告》提及的国家...
- 《若干政策》第 (一...
- 《若干政策》第 (六...
- 《若干政策》第 (六...
- 《若干政策》第 (三...
- 《若干政策》第 (八...
- 《若干政策》第 (三...
- 《若干政策》第 (一...

企业具有保证产品生产的手段和能力的证明材料 (包括采购设备清单等)

企业主要工艺、产品列表

本项政策申报要求提交的其他证明材料

* 与主要客户签订的两份代表性销售合同扫描件 (外文合同, 请翻译成中文一并上传)

[点击上传](#)

合同首页+金额页+盖章页。上传最大支持上传9个文件, 单个文件大小不超过10M, 如文件过大, 请压缩后上传。

省级发展改革委、工业和信息化主管部门要求出具的其他材料 (非必填)

[点击上传](#)

上传最大支持上传9个文件, 单个文件大小不超过10M, 如文件过大, 请压缩后上传。

* 上传企业申请表

[点击上传](#)

请确保除此企业申请表项, 其他必填项均已填写后, 点击暂存按钮。企业需生成纸质文件 (点击“操作”一栏下的“生成纸质文件”) 加盖企业公章后, 扫描为PDF格式上传。文件大小不超过10M, 如文件过大, 请压缩后上传。

* 请知悉

提交申请后, 企业需生成纸质文件 (点击“操作”一栏下的“生成纸质文件”) 加盖企业公章连同必要证明材料 (电子版、纸质版) 报本省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委或工业和信息化主管部门 (由地方发展改革委确定接收单位)

[暂存](#) [提交](#) [返回](#)

- ★ 填报结束, 要认真核对无误
- ★ 导出申请表, 盖章后上传
- ★ 申报完成, 务必提交
- ★ 提交后, 尽快将纸质文件寄往江苏省半导体协会

三、申报方法和材料准备 (材料清单)

附件3: 提交的材料明细表

附件 3

享受税收优惠政策的集成电路企业、项目和软件企业提交材料明细表

序号	企业或项目类型	材料清单 (复印件须加盖企业公章)
一	享受《若干政策》第(一)条的集成电路生产企业或项目,以及《公告》相关政策的集成电路生产企业或项目归属企业	<ol style="list-style-type: none"> 1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等;(可提供相应查询网址) 2.项目备案文件(备案表);(可提供相应查询网址) 3.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占职工总数的比例说明,企业研究开发人员名单,以及汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明(包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证)等相关证明材料; 4.企业主要工艺、产品列表(名称/规格); 5.企业拥有与主营产品相关的发明专利等证明材料; 6.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告(包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等)和集成电路制造销售(营业)收入、自有集成电路产品制造销售(营业)收入、研究开发费用等情况表;研究开发费用按财税[2015]119号文及国家税务总局2017年第40号公告要求的口径归集后,在会计报告中单独说明,不能说明的需提供按照上述口径的研究开发费用专项审计报告或税务鉴证报告; 7.与主要客户签订的两份代表性销售合同复印件; 8.企业具有保证产品生产的手段和能力的证明材料(包括采购设备清单等); 9.省级发展改革委(工业和信息化主管部门)要求出具的其他材料。
二	享受《若干政策》第(三)、(七)条以及《公告》相关政策的重点集成电路设计企业	<ol style="list-style-type: none"> 1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等;(可提供相应查询网址) 2.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占职工总数的比例说明,企业研究开发人员名单,以及汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明(包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证)等相关证明材料; 3.企业开发销售的主要产品和服务列表(名称/重点领域/对应销售(营业)收入规模); 4.企业拥有与主营产品相关的不少于8项的已授权发明专利(企业为第一权利人)、布图设计登记、计算机软件著作权登记证书的证明材料; 5.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告(包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等)和集成电路设计销售(营业)收入、集成电路自主设计销售(营业)收入、研究开发费用等情况表;研究开发费用按财税[2015]119号文及国家税务总局2017年第40号公告要求的口径归集后,在会计报告中单独说明,不能说明的需提供按照上述口径的研究开发费用专项审计报告或税务鉴证报告;

三、申报方法和材料准备 (材料清单)

序号	企业或项目类型	材料清单 (复印件须加盖企业公章)
		<p>6.第三方检测机构提供的集成电路产品测试报告或用户报告,以及与主要客户签订的两份代表性销售合同复印件;</p> <p>7.税务鉴证报告等可说明企业符合应纳税所得额条件的证明材料;</p> <p>8.企业具有与集成电路设计相适应的软硬件设施等开发环境的证明材料;</p> <p>9.省级发展改革委(工业和信息化主管部门)要求出具的其他材料。</p>
三	享受《若干政策》第(三)、(七)相关政策的重点软件企业	<p>1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等;(可提供相应查询网址)</p> <p>2.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占职工总数的比例说明,企业研究开发人员名单,以及汇算清缴年度最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明(包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证)等相关证明材料;</p> <p>3.企业开发销售的主要软件产品列表(名称/重点领域/对应销售(营业)收入规模);其中申报公有云服务软件企业应明确区分列明企业公有云、私有云、混合云收入;</p> <p>4.企业具有所申报领域相应的已授权发明专利不少于2项(企业为第一权利人),相应领域计算机软件著作权登记证书不少于2项(均应具备对应的测试报告)的证明材料;</p> <p>5.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告(包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等)和软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入、软件产品自主开发销售(营业)收入、研究开发费用、境内研究开发费用等情况表;研究开发费用按财税〔2015〕119号文及国家税务总局2017年第40号公告要求的口径归集后,在会计报告中单独说明,不能说明的需提供按照上述口径的研究开发费用专项审计报告或税务鉴证报告;其中申报嵌入式软件企业应明确企业软硬件收入情况,并提供合同、发票等软件收入比例不低于50%的证明材料(不要求提供全部合同,仅需提供能证明符合申报条件的大额合同及合同中的必要内容);</p> <p>6.汇算清缴年度与申报领域相关的合同列表(包含甲乙双方、单价、总金额、交易内容、签约和付款时间等信息),以及发票等销售凭证;</p> <p>7.与主要客户签订的两份代表性销售合同复印件;</p> <p>8.税务鉴证报告等可说明企业符合应纳税所得额条件的证明材料;</p> <p>9.企业具有与软件开发相适应软硬件设施等开发环境(如合法的开发工具等)的证明材料;</p> <p>10.省级发展改革委(工业和信息化主管部门)要求出具的其他材料。</p>
四	享受《若干政策》第(六)条相关政策的集成电路生产企业和财关	<p>1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等;(可提供相应查询网址)</p> <p>2.项目备案文件(备案表)(可提供相应查询网址);</p> <p>3.企业具有保证产品生产的手段和能力的证明材料(包括采购设备清单等),先进封装、测试企业需提供按封装产品颗粒数或晶圆数(折合8英寸)计算,先进封装测试(晶圆级封装、系统级封装、2.5维和3维封装)规划产能占总规划产能比例</p>

三、申报方法和材料准备（材料清单）

序号	企业或项目类型	材料清单（复印件须加盖企业公章）
	税〔2021〕4号文提及的关键原材料、零配件生产企业	不低于40%的证明材料； 4.省级发展改革委（工业和信息化主管部门）要求出具的其他材料。
五	享受《若干政策》第（八）条相关政策的集成电路重大项目	1.项目企业对应类别集成电路企业条件材料清单； 2.固定资产投资额相关证明材料； 3.项目开工时间、拟竣工时间、备案时间、项目类型、产品类型、工艺线宽、总规划产能、先进封装测试规划产能、2020年7月27日后申请进口环节增值税分期纳税的首台新设备进口时间、进口设备总金额、进口环节增值税额的相关证明材料； 4.省级发展改革委（工业和信息化主管部门）要求出具的其他材料。

注：上述企业类型、材料清单依据国发〔2020〕8号文和《公告》制定，材料模板请咨询省级发展改革委（工业和信息化主管部门），填报说明见信息填报系统。

三、申报方法和材料准备（材料准备）

(5) 中介机构鉴证的审计报告——上年度会计报告（财务审计）、集成电路制造（或设计）销售收入审计报告、
研究开发费用专项审计报告（加计扣除鉴证报告）

这三项审计报告是申报必须的关键材料，要在申报系统中**分别**上传

★ 上年度会计报告（财务审计）——要在申报系统关闭前提交，不能延期。

★ 集成电路制造（或设计）销售收入审计报告：

- 生产企业——上年度集成电路制造销售收入，占企业收入总额的比例。
- 重点设计企业——上年度集成电路设计销售收入、自主设计销售收入；

集成电路设计销售收入、自主设计销售收入分别占企业收入总额的比例。

其中第二类设计企业：选择领域的设计销售收入，以及占本企业设计销售（营业）收入的比例。

★ 研究开发费用专项审计报告——要依据财税（2015）119号和税务总局2017年40号公告的口径。

上年度符合上述口径的研发费总额、占企业销售收入总额的比例。

★ **重点设计企业，还要提供税务鉴证报告等说明企业符合应纳税所得额条件的证明材料（税审报告）。**

三、申报方法和材料准备（材料准备）

(6) 其他证明材料—与主要客户签订的两份代表性销售合同（生产企业和重点设计企业）；

第三方机构提供的产品测试报告或用户报告（重点设计企业）

具有保证产品生产的手段和能力的证明材料（生产企业，包括重要设备清单、现场照片等）

具有与集成电路设计相适应的开发环境证明（重点设计企业，使用正版EDA工具的证明：购买或租用合同、付款凭证等）

★ 申请关税减免的逻辑电路、特色工艺、化合物半导体企业：

项目备案文件

保证产品生产的手段和能力的证明材料（设备清单、工艺和产品说明、代表性合同、现场照片等）

★ 申请关税减免的先进封装企业：

项目备案文件

保证产品生产的手段和能力的证明材料（设备清单、工艺和产品说明、代表性合同、现场照片等）

按照产品颗粒数或晶圆数（折算为8英寸）计算的先进封装测试（晶圆级、系统级、2.5D/3D）规划产能占总规划产能比例

★ 申请关税减免的关键原材料、零配件企业（仅限靶材、光刻胶、掩模版、封装载板、抛光垫、抛光液、8英寸及以上硅单晶、8英寸及以上硅片）

项目备案文件

企业主要产品符合以上类别的证明（产品情况说明、销售合同、检测检验报告等）

保证产品生产的手段和能力的证明材料（设备清单、工艺和产品说明、代表性合同、现场照片等）

为佐证系统填报的数据，申报关税减免的企业在书面材料中也要提交财务报表，研发投入、企业人员情况说明和拥有的主要知识产权等材料



三、申报方法和材料准备（材料准备）

关于书面材料和网上申报中上传的材料

- 网上申报过程中规定只要上传提交《材料清单》中的主要部分，而书面材料需要提供完整的全套材料。
- 省级的推荐主要是依据书面材料。
- 书面材料的完整性非常重要，不能因为申报系统没有要求上传就不准备、不提供
- 申报系统提示：**经审计的完整纸质版会计报告交省级发展改革委（工业和信息化主管部门）留档备查。**

示例

- 企业法人营业执照副本，其他相关的资质证书（备案证明、高企证书、体系认证）等；
- 企业职工人数、学历结构、研发人员情况及占职工总数的比例说明，研发人员名单，汇算清缴年度最后一个月职工社保缴纳证明等证明材料。
- 企业开发销售的主要产品和服务列表（名称/重点领域/对应销售收入规模）；
- 拥有的与主营业务相关的不少于8项发明专利、布图登记、计算机软著证书等证明（**建议上传**）；
- 经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度会计报告和集成电路设计销售收入、集成电路自主设计销售收入、研究开发费用等情况表；研究开发费用按财税（2015）119号文及国家税务总局2017年40号公告要求的口径归集后，在会计报告中单独说明，不能说明的需提供按照上述口径的研究开发费用专项审计报告或税务鉴证报告；
- 第三方检测机构提供的集成电路产品测试报告或用户报告，以及与主要客户签订的两份代表性销售合同复印件；
- 税务鉴证报告等可说明企业符合应纳税所得额条件的证明材料；
- 企业具有与集成电路设计相适应的软硬件设施等开发环境的证明材料；
- 省级发展改革委（工业和信息化主管部门）要求出具的其他材料。

四、申报过程中注意事项



四、申报过程中注意事项

1

认真研读申报通知，全面理解规定要求

- 申报通知和附件，以及申报页面上的“填报说明”非常重要，认真研读可以解决大部分疑问；
- 《申报系统企业填报使用手册》可以找2023年的申报通知附件，其中有系统技术支持的联系方式；
- 除“重大项目”外，其余每年都需要申请，错过或漏报只有等到下一年；
- 选准申报类别，是申报成功的首要条件；
- 根据企业情况 and 需求，可以同时申报几个项目，要注意合理性，不能相互冲突或矛盾；
- 集成电路制造企业（项目）、第三代半导体企业要符合国家规划布局。

2

申请所得税和研发费120%

- 根据企业自身情况 and 需求，可以两项都申报，也可以选择只申报其中的一项；
- 两者虽然条件和材料一样，但不申报不能自动享受，注意不要漏报；
- 每项都需要单独提供一套书面材料（材料内容相同），要在材料封面标明申报的优惠项目以便区分。
- 申报重点设计企业的同时如果也申报研发费120%加计扣除，需要按照120%加计扣除来核算**应纳税所得额**能否达到要求，如果不达标会造成两项申报都通过。

四、申报过程中注意事项

3

财务审计和专项审计报告

- ◆ 申报所得税优惠和研发费120%，财务审计、集成电路收入和研发投入专项审计是非常重要的必备材料，务必认真准备；
- ◆ 不要使用申报高新企业、高新产品的审计报告来代替，范围和口径不同；
- ◆ 申报重点设计企业，集成电路设计销售收入专项审计中要包括：集成电路设计销售收入、自主设计销售收入、设计销售收入占企业总收入的比例、自主设计销售收入占总收入的比例等结论；
- ◆ 申报二类重点设计企业，还要包括选择的重点领域（只能选一个）的设计销售收入、重点领域设计销售收入占企业设计销售收入的比例等结论；
- ◆ 重点设计企业还需要提交所得税审核报告，证明应纳税所得额符合要求；
- ◆ 强调研发费审计要按照财税（2015）119号文件和税务总局2017年40号公告的口径；
- ◆ 在申报系统需要标注报告页码的地方，最好标注清楚，便于审核人员找到对应的数据；
- ◆ 审计报告应当每份单独上传，且文件名标注清楚，不要混在一起打包上传；
- ◆ 审计报告必须在申报期间通过申报系统上传，不能后补。请不要再提类似问题。

四、申报过程中注意事项

4

注意证明材料的相关性和有效性

- 测试检验报告、用户意见、专利等知识产权要与申报的领域有足够的相关性；
- 按照二类申报重点设计企业，提供的上述材料要与选择的重点领域强相关；
- 专利证书等证明材料的取得时间限2025年底前，第一权利人；因企业名称变更造成证明材料名称不一致的，需附变更登记手续；
- 重点设计企业要提交有效的正版EDA购买或租用合同、发票及付款凭证，能够在时间和内容上支撑产品设计开发；
- 先进封装企业要提供先进封装规划产能占企业封装规划产能比重的计算说明，注意是产能不是产量；
- 关键材料、零部件企业提供的备案文件、产品销售、用户使用等证明要说明产品符合规定的类别；

四、申报过程中注意事项

5

书面材料

- 书面材料是省级推荐的主要依据，在完成申报后尽快寄出（江苏半导体协会）；
- 按照《通知》附件的“材料明细表”提供书面材料；
- 制做一个材料封面，标明申报类别、企业名称、地区等；
- 按照封面、消息表、材料清单所示的顺序装订；
- 书面材料一份，胶装，同时提供电子文档（光盘或U盘）；
- 每申报的一个项目，都要单独提供一份书面材料；
- 材料要齐全，同时也要适量，不要求过多

收件地址：

无锡市滨湖区建筑西路777号集成电路设计园A10幢201室
江苏省半导体行业协会
胡建 051081190090

6

参考模板和说明课件

- 人员情况说明、研发人员名单、产品和工艺列表等可参考转请核查“留存备查资料”当中的模板；
- 在“江苏省半导体行业协会”官网，“优惠备案”栏目内下载；
- 本课件留在上述栏目内备查阅，仅供参考。

四、申报过程中注意事项

7

及时跟踪审批情况、出现重大变化进行变更申请

- 按照《通知》规定的时间，进入申报系统查询批准结果，**务必下载或截图保留**；
 - 批准文件不公开，如果审批通过企业的税收、关税申报的系统会显示出来；
 - 政策落实过程中如果需要相关证明，请向当地发展改革委申请；
 - 在政策执行期内企业情况出现重大变化，及时向所在地方发改委提交《企业重大情况变化表》（通知的附件四），以免过期失去优惠政策享受资格。
-

以上说明仅仅是根据个人对文件的理解和工作积累整理，可能存在偏差和错误。

请务必遵照文件和申报系统的要求进行申报。

感谢华润微电子公司在网络会议系统方面给予的大力支持！

资料网址、咨询联系方式

相关文件、表格模板、说明会PPT查询：

江苏省半导体行业协会 (<http://www.jssia.cn/>)  优惠备案 (图标)  资料下载

咨询联系电话：

集成电路生产企业、重点设计企业— 所得税、研发费120%： 张翼 15852810092

特色工艺、化合物半导体、关键原材料零部件企业—关税： 施勇勇 18018304290

先进封装企业—关税： 陈浩鹏 13485177790

申报系统支持：18810748372 杨老师

江苏省半导体行业协会

地址：无锡市滨湖区建筑西路777号集成电路设计园A10幢201室

网站：<http://www.jssia.cn/>

电邮：cjssia@yeah.net

电话：0510-81190090





Thank You
感谢聆听

